



2015年3月

株式会社三井住友銀行 企業調査部

香港駐在 神谷 直良

## アジア新興国スマートフォン市場を狙う電子部品メーカーの戦略

業界筋では、足元で電子部品市場をけん引する中国の低価格スマートフォン（以下、スマホ）市場に成熟期が迫るとの見方が強まっており、これに代わる成長市場であるアジア新興国のスマホ需要取り込みに向けた電子部品メーカーの動きに関心が集まっています。

### アジア新興国スマホ市場が新たな成長市場となる

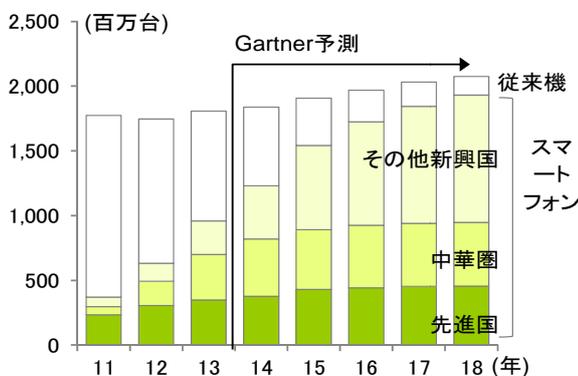
中国スマホ市場は、足元で携帯電話従来機からの買い替えを主体として急速に拡大していますが、目先数年のうちに中国国内のスマホ利用率が飽和点に到達し、台数ベースで需要拡大のペースが急速に鈍化するとみられています。また、製品面での差別化が難しくなっていることを背景に単価下落が加速し、金額ベースでは縮小に転じるとする向きもあります。

こうした中で、新たな成長市場の一つとしてインドなどアジア新興国のスマホ市場に注目が集まっています。この市場は、域内に20億人超の人口を有する

え、2013年末時点で携帯電話の人口普及率は5割未満、うちスマホ利用率は2割未満と普及の余地が大きく、今後大幅な需要拡大が期待されています。

日本の電子部品メーカーにとっては、当該地域の主体である100米ドル未満の超低価格端末は機能が絞り込まれ部品の搭載金額も小さいことから、現状のビジネス規模は限定的とみられます。一方、当該地域では上位中間層以上の所得者（1人当たり年間所得4,000米ドル以上）が増加してきており、今後これら所得層をターゲットにした高速通信規格LTEサービスや100～200米ドル程度と中国同様の低価格帯のLTE対応スマホなどが、相応の規模に拡大していくとみられます。実際、アジア新興国各国では携帯キャリアがLTE対応端末をはじめ高水準の機能を備えたスマホの価格が下がってきたことを受けて、加入者拡大を狙ってスマホメーカーと連携した端末価格・通信料金のプランを打ち出す動きが出ており、例えばインドでは第3世代とLTEの加入者数が目先数年で、2億人にまで拡大するとの声もあります。こうした中で、日本の電子部品メーカーは、LTE対応端末に不可欠な通信関連部品などを中心に、今後売上を伸ばしていくことが期待されます。

図表 携帯電話端末 販売台数（世界）



（資料）Gartner “Forecast: PCs, Ultramobiles and Mobile Phones Worldwide, 2011–2018, 4Q14 Update”

15 Dec 2014 を基に弊行がグラフを作成。

本資料は、情報提供を目的に作成されたものであり、何らかの取引を誘引することを目的としたものではありません。本資料は、作成日時時点で弊行が一般に信頼できるとされる資料に基づいて作成されたものですが、情報の正確性・完全性を弊行で保証する性格のものではありません。また、本資料の情報の内容は、経済情勢等の変化により変更されることがありますので、ご了承ください。ご利用に際しては、お客さまご自身の判断にてお取扱いいただきますようお願い致します。本資料の一部または全部を、電子的または機械的な手段を問わず、無断での複製または転送等することを禁じております。

### セットメーカーと競合部品メーカーの動向の変化に伴う新たな課題

もともと、アジア新興国市場を軸にしてセットメーカーおよび競合のアジア電子部品メーカーの動きに変化がみられ、



これに伴って日本の電子部品メーカーにとっての新たな課題が生じ始めています。

### ①スマホメーカーの選別

まず各国で地場スマホメーカーが積極的な広告宣伝などにより一定の市場地位を占めているうえ、自国内の需要を取り込んで事業規模や資金力を高めた中国スマホメーカーが、既にアジア新興国へ本格展開を進めています。さらに、先進国スマホメーカーも自社部品事業の稼働率を引き上げるべく採算を度外視して低価格品に高スペック部品を積み込んだ製品を投入するなど競合が激化しており、電子部品メーカーにとって勝ち残るセットメーカーの見極めが難しくなっています。

### ②多様化への対応

国ごと・地域ごとで消費者の嗜好や販売チャネルなどが異なり、部品にも相応のカスタマイズが求められるようになりつつあります。また、部品を納入するスマホ生産拠点でも、足元では中国の端末組立事業者が中心となっていますが、長期的には地場のスマホメーカーが設計・開発・製造の内製化や自国内での組み立て工程の本格展開を志向するなど、生産拠点が各国・各地域に分散する方向にあり、これに合わせたサプライチェーンの構築を見据える必要があります。

### ③アジア電子部品メーカーとの競合激化

競合する中・台などのアジア電子部品メーカーが、技術進歩が頭打ちとなりつつある分野を中心に、政府による資金支援も得つつ、技術的なキャッチアップや生産能力の拡大を進めています。加えて、低価格スマホにおいて設計・製造のレシ

ピを公開する中央演算半導体(アプリケーションプロセッサ)の設計会社が部品調達に影響力を持つなか、中国の半導体設計会社が政府の後押しを得て、アジア新興国向け部品のサプライチェーンを中国国内で囲い込む動きもみられるなど、競合が激しさを増しています。

### 日本の電子部品メーカーの方向性

日本の電子部品メーカーは、高付加価値ながら端末コストに占める割合が低く単価引き下げ圧力が相対的に小さい製品分野や、高度な開発・生産技術開発が必要な製品分野などで今後も競争力を維持するものとみられます。但し、アジア新興国向けビジネスを着実に取り込むべく、既述の課題に対しては、①M&A などを通じ、強みを有する分野に関連する技術領域を取り込んで製品ポートフォリオを拡充し、端末メーカーおよび半導体設計会社へのモジュール提供などにより提案力を強化すること、②顧客のカスタマイズニーズをよく研究した上で可能な限り汎用化を進め、コスト競争力を引き上げるとともに販売先に対する柔軟性を確保すること、などの取り組みが必要で、既に実行に移している先も見受けられます。

さらに今後は、生産拠点の分散をはじめ、サプライチェーンの構築が複雑になることも予想され、各国の政策を含め市場動向把握に向けた営業・開発拠点の新設や、地場企業との協業体制も必要になるとみられ、部品メーカー各社の今後の取り組みは要注目です。(神谷)

本資料は、情報提供を目的に作成されたものであり、何らかの取引を誘引することを目的としたものではありません。本資料は、作成日時時点で弊行が一般に信頼できるとされる資料に基づいて作成されたものですが、情報の正確性・完全性を弊行で保証する性格のものではありません。また、本資料の情報の内容は、経済情勢等の変化により変更されることがありますので、ご了承ください。ご利用に際しては、お客さまご自身の判断にてお取扱いくださいますようお願い致します。本資料の一部または全部を、電子的または機械的手段を問わず、無断での複製または転送等することを禁じております。